

(1,00mm) .03937"

SAL1 系列

SAL1-127-01-S-S-A

SAL1-140-01-S-S-A

SAL1-120-01-S-S-A

高速微型板插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?SAL1

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
镀铜
电镀:
在 50μ" (1.27μm)
的镍上镀金或锡
工作温度:
-55°C 至 +125°C
额定电流:
在 80°C 时为 2.3 A
符合 RoHS 规范要求:
是

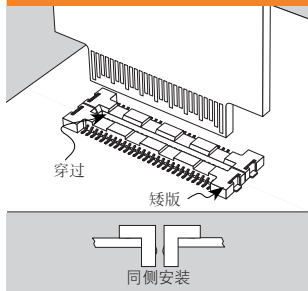


加工:
可无铅焊接:
是

SMT 引线共面性:
(0,10mm) .004" 最大

配接:
(1,60mm) .062" 或
(2,40mm) .093" 卡

应用



1.65mm 堆叠高度	在 3dB 插入损耗的额定值
单端信号	8.5 GHz / 17 Gbps
差分对信号	9.0 GHz / 18 Gbps
如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?SAL1 或联系 sig@samtec.com	

在同侧或对侧上成对安装, 便于信号路由

表面贴装

焊接接片

SATALink™
Compatible

SATALink™ 是
Silicon Image Inc. 的商标。

(1,00mm)
.03937"
间距

多种配接卡厚度

大转角镀铜触点

特殊应用选项

提供厚镀金。
请致电 Samtec。

SAL1

1

位置数

01

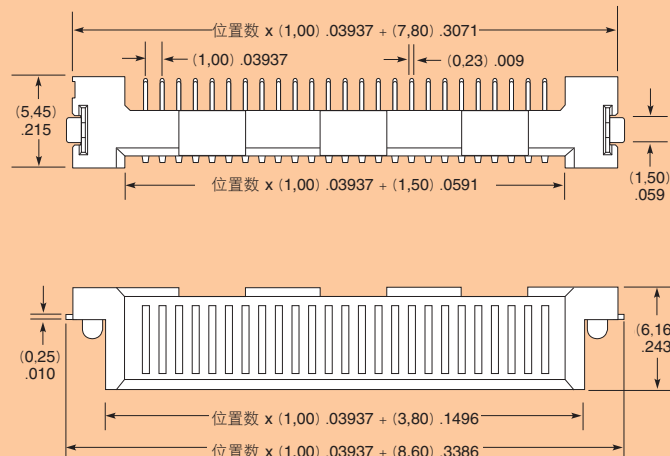
电镀
选项

S

A

20, 27, 30, 40

-S
= 30μ" (0.76μm) 触点镀金,
尾端镀雾锡



注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM